

10

9

8

7

6

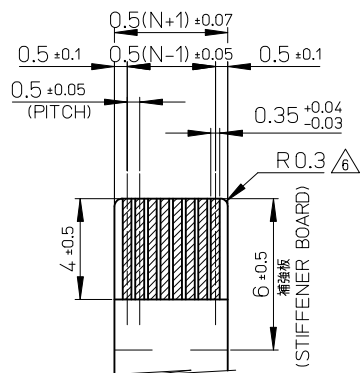
5

4

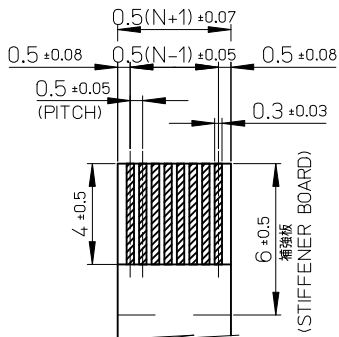
3

2

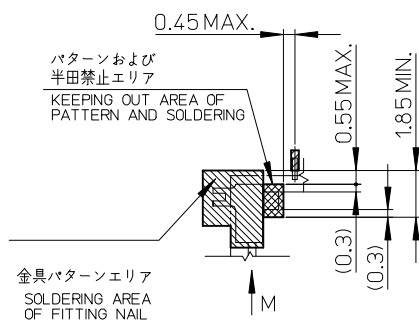
1



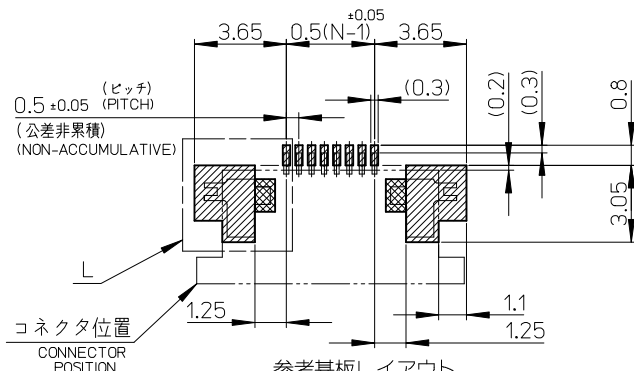
適合銅系めっきFPC推奨寸法
APPLICABLE FPC OF TIN
PLATING RECOMMENDED DIMENSION
仕上がり厚さ: 0.3 ± 0.05
THICKNESS: 0.3 ± 0.05/-0.05



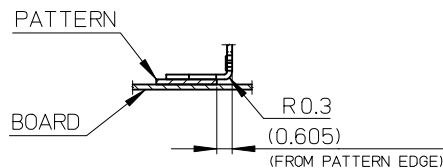
適合銅系めっきFFC推奨寸法
APPLICABLE FFC OF TIN
PLATING RECOMMENDED DIMENSION
仕上がり厚さ: 0.3 ± 0.05
THICKNESS: 0.3 ± 0.05/-0.05



DETAIL L



参考基板レイアウト
(マウント面)
RECOMMENDED P.C. BOARD
PATTERN DIMENSION (REF.)
(MOUNTING SIDE)



VIEW M
(DETAIL OF FITTING NAIL
ON PATTERN)

注記NOTES

1.使用材料

MATERIAL

ハウジング: 46ナイロン、ガラス充填、UL94V-0、白
HOUSING: PA46, GLASS FILLED, UL94V-0, WHITE
アクチュエータ: ポリフェニレンサルフィド (PPS)、ガラス充填、UL94V-0、茶色
ACTUATOR: POLYPHENYLENE SULFIDE, GLASS FILLED, UL94V-0, BROWN
ターミナル: リン青銅、ニッケル下地銅ビスマスめっき (t=0.2)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE, TIN BISMUTH OVER NICKEL PLATING
金具: リン青銅、ニッケル下地銅めっき (t=0.2)
FITTING NAIL: PHOSPHOR BRONZE, TIN OVER NICKEL PLATING

2.エンボステープ梱包時は、アクチュエータがロックした状態になります。

IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART
NO.52437-**-26 SHOULD BE LOCKED.

3. ソルダータール半田付け面のズレ量、及び金具半田付け面のズレ量は、
基準面Hに対して上方向に0.1MAXIMUM、下方向0.15MAXIMUMとする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS FROM
DATUM-H.

UPPER DIRECTION: 0.1 MAXIMUM
LOWER DIRECTION: 0.15 MAXIMUM

4. 偶数極に適用

APPLY FOR EVEN CIRCUIT.

5. ハターン剥離止め金具

FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.W.B. PATTERN.

6. R0.3は、FPCの導体部にかからないこと

R0.3 MUST NOT BE OVERLAPED TO PATTERN OF FPC.

7. ソルダータールの平坦度は、0.1MAXIMUMとする。

SOLDER TAIL COPLANARITY IS 0.1 MAXIMUM.

8. ELV 及び RoHS 適合品

ELV AND RoHS COMPLIANT

FPCについて:

打抜き方向は導体側から補強板側を推奨致します。
補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。

ABOUT FPC:

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION :
FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.

RECOMMENDED MATERIAL:
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT

REVISED	EC NO. J2013-1532	2013/06/21 DRAWN: NINOUE01 CHKD: HIJIMA APPR: YNOGAWA	2013/06/21 2013/06/28	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
					10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY YSAKIYAM	DATE '04/01/08	TITLE 0.5 FPC CONN. ZIF FOR SMT R/A (BOTTOM CONTACT) TIN-BISMUTH PLATING			
					10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY MSASAO	DATE '04/01/08				
					30 OVER	± 0.3	APPROVED BY MSASAO	DATE '04/01/08				
					ANGULAR ± 3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.			SHEET NO.
					DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-52437-017			2 OF 2
							THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

9

8

7

6

5

4

3

2

A

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E

D

C

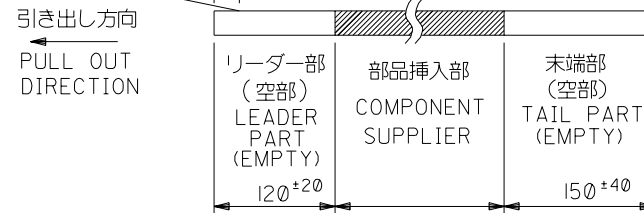
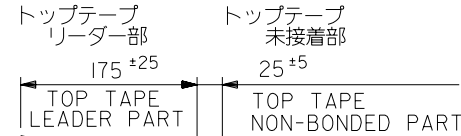
B

A

SD-52437-018

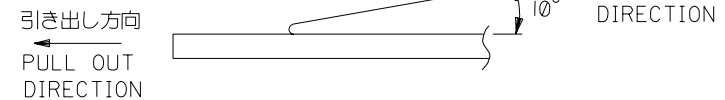
注記 NOTES

- 製品番号 52437-***26 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52437-017 を参照下さい。
IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.52437-***26 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS,SEE SD-52437-017.
- 梱包数量：1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



- トップテープの剥離強度：(剥離方向は下図参照)
0.1N~1.3N {10gf~130gf}尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1N ~1.3N(10gf ~130gf)(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION



5. 材料 (MATERIAL)

キャリアテープ (CARRIER TAPE) : ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOPTAPE) : PET, PE, PEF
リール (REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYREN (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

6. 本製品は 52437-***91 の鉛フリー品である。

THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52437-***91.

EC NO.
DRWN:
CHK:
APPR:

EC NO.
DRWN:
CHK:
APPR:

EC NO.
DRWN:
CHK:
APPR:

REVISED '04/02/09

EC NO. J2004-2350

DRWN: N.AIDA

CHK: K.TOJO

APPR: M.SASAO

RELEASED '04/01/08

EC NO. J2004-1850

DRWN: Y.SAKIYAMA

CHK: M.SASAO

APPR: M.SASAO

DESCRIPTION

REVISION

REV

INS. RANGE

被覆外径

WIRE RANGE

適用電線範囲

FINISH

仕上げ

MATERIAL

材料

GENERAL TOLERANCES:

(UNLESS SPECIFIED)

一般公差

10 UNDER

未満

±0.2

10 OVER

以上

30 UNDER

未満

±0.25

30 OVER

以上

±0.3

ANGLE

角度

±3°

SCALE

1:1

DESIGN UNITS

mm

THIRD ANGLE

PROJECTION

DIMENSIONS:

mm

INCH

mm

ONLY

SHT

REV

REVISE ON

CAD ONLY

TITLE:

0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT RA

With Tape Embstp Pkg -LEAD FREE-

MOLEX INCORPORATED

SD-52437-018.S01

8

7

6

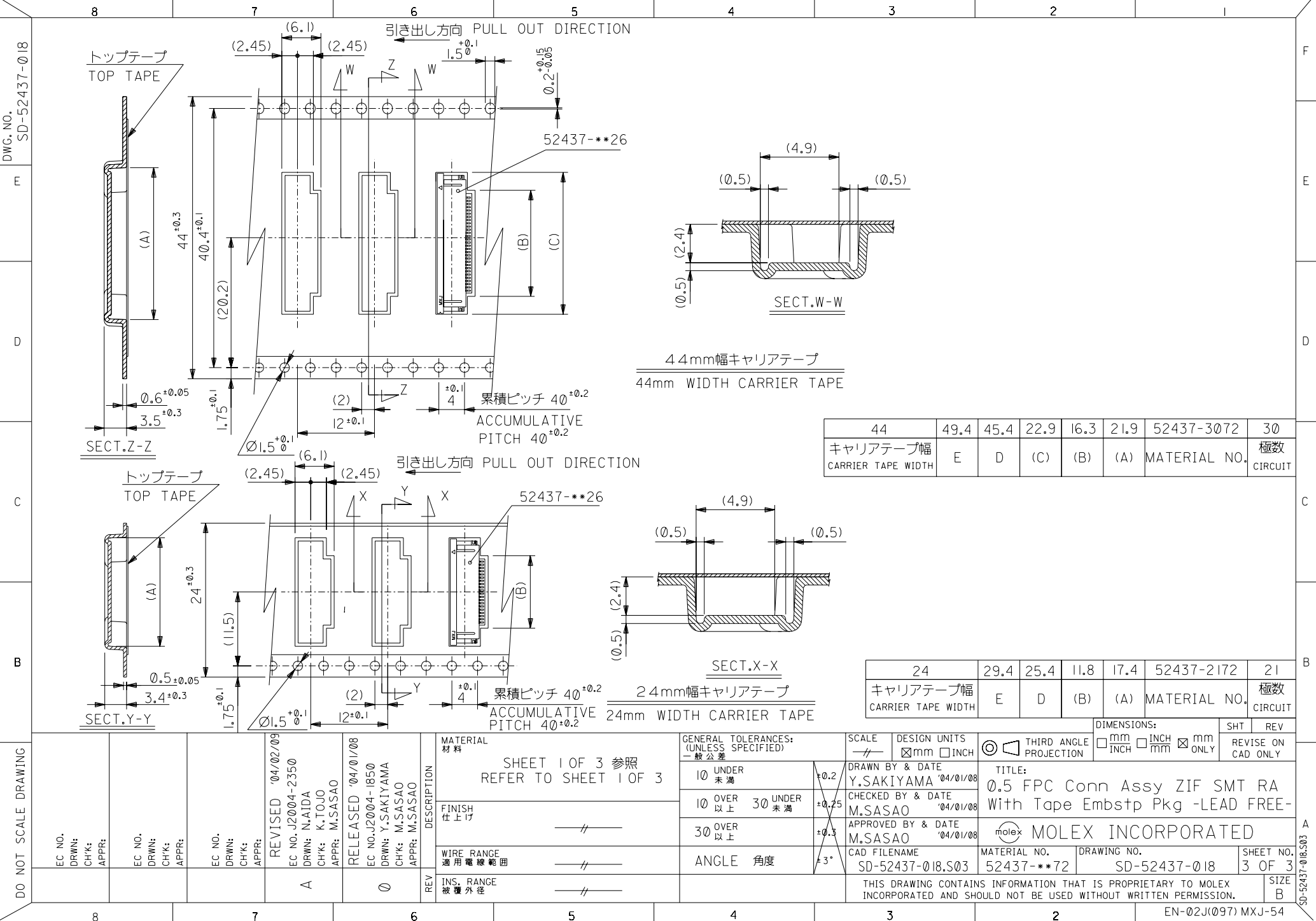
5

4

3

2

EN-02J(097) MXJ-54



8 7 6 5 4 3 2 1

DWG. NO. SD-52437-018

DO NOT SCALE DRAWING

EC NO. DRWN: CH'K: APPR:	EC NO. DRWN: CH'K: APPR:	EC NO. DRWN: CH'K: APPR:	REVISED '04/02/09 EC NO. J2004-2350 DRWN: N.AIDA CH'K: K.TOJO APPR: M.SASAO	RELEASED '04/01/08 EC NO. J2004-1850 DRWN: Y.SAKIYAMA CH'K: M.SASAO APPR: M.SASAO	DESCRIPTION REV
			A	Q	
					INS. RANGE 被覆外径

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	10 UNDER 未満	±0.2
	10 OVER 30 UNDER 以上 未満	±0.25
	30 OVER 以上	±0.3
	ANGLE 角度	±3°

SCALE —//—	DESIGN UNITS ☑mm □INCH	THIRD ANGLE PROJECTION	DIMENSIONS: □mm □INCH ☑mm ONLY	SHT REVISION	REV ON CAD ONLY
DRAWN BY & DATE Y.SAKIYAMA '04/01/08	CHECKED BY & DATE M.SASAO '04/01/08	APPROVED BY & DATE M.SASAO '04/01/08	CAD FILENAME SD-52437-018.S03	MATERIAL NO. 52437-***72	DRAWING NO. SD-52437-018
TITLE: 0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT RA With Tape Embstp Pkg -LEAD FREE-					
MOLEX INCORPORATED					
				SHEET NO. 3 OF 3	SIZE B

44	49.4	45.4	22.9	16.3	21.9	52437-3072	30
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT

24	29.4	25.4	11.8	17.4	52437-2172	21
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT

F

E

D

C

B

A

SD-52437-018.S03